

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 7 月 12 日 (2007.7.12)

【公表番号】特表 2003-521119 (P2003-521119A)
 【公表日】平成 15 年 7 月 8 日 (2003.7.8)
 【出願番号】特願 2001-555112 (P2001-555112)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/12 B

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 5 月 23 日 (2007.5.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子パッケージであって、

第 1 面と第 2 面とを有し、複数の相互接続パッドを画定するようにパターンニングされる導電トレース層と、

該導電トレース層の該第 1 面に取付けられる誘電体層と、

第 1 導電層と、第 2 導電層と、該第 1 導電層と該第 2 導電層との間に配置される誘電体材料の層と、を有し、該第 1 導電層が該導電トレース層の該第 2 面に取付けられるコンデンサと、

該コンデンサの該第 1 導電層と該誘電体材料層とを通過して延在する複数の相互接続領域と、

該コンデンサの該導電層の各々と該相互接続パッドの対応するセットとの間に接続された相互接続部材であって、該コンデンサの該第 1 導電層が該相互接続パッドの第 1 セットに電氣的に接続され、該コンデンサの該第 2 導電層が該相互接続パッドの第 2 セットに電氣的に接続され、相互接続パッドの該第 2 セットに対応する相互接続部材が、該相互接続領域のうちの 1 つを通過して延在する、相互接続部材と、

を具備することを特徴とする電子パッケージ。

【請求項 2】

前記コンデンサの前記第 2 導電層を支持する電氣的導電補強部材と、前記誘電体層、前記導電トレース層および該コンデンサを通過して延在する機器収容領域と、をさらに具備し、該補強部材の該機器収容領域に取付けられる電子機器をさらに具備することを特徴とする、請求項 1 記載の電子パッケージ。

【請求項 3】

前記コンデンサの前記誘電体材料が、5 μm から 30 μm までの厚さを有することを特徴とする、請求項 1 又は 2 のいずれか 1 項に記載の電子パッケージ。

【請求項 4】

前記誘電体材料が、高誘電率粒子と混合された非導電重合体から作製され、該高誘電率粒子が、チタン酸バリウム、チタン酸バリウムストロンチウム、酸化チタン、チタン酸ジルコン鉛および酸化タンタルからなるグループから選択された材料から形成されていることを特徴とする、請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の電子パッケージ。

【請求項 5】

電子パッケージであって、

第 1 面と第 2 面とを有し、複数の相互接続パッドを画定するようにパターンニングされた導電トレース層と、

該導電トレース層の該第 1 面に取付けられたフレキシブル誘電体層と、

第 1 導電層と、第 2 導電層と、該第 1 導電層と該第 2 導電層との間に配置された誘電体材料の層と、を有し、該第 1 導電層が該導電トレース層の該第 2 面に取付けられるフレキシブルコンデンサと、

該コンデンサの該第 1 導電層と該誘電体材料層とを通過して延在する複数の相互接続領域と、

該コンデンサの該導電層の各々と該相互接続パッドの対応するセットとの間に接続された相互接続部材であって、該コンデンサの該第 1 導電層が該相互接続パッドの第 1 セットに電氣的に接続され、該コンデンサの該第 2 導電層が該相互接続パッドの第 2 セットに電氣的に接続され、相互接続パッドの該第 2 セットに対応する相互接続部材が、該相互接続領域のうちの 1 つを通過して延在する、相互接続部材と、

該相互接続パッドの各々に隣接する該誘電体層を通過して延在する孔と、

該コンデンサの該第 2 導電層に隣接して取付けられる補強部材と、

該誘電体層、該導電トレース層および該コンデンサを通過して形成される機器収容領域と、
を具備することを特徴とする電子パッケージ。